

中信建投证券股份有限公司
关于联芸科技（杭州）股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司名称：联芸科技（杭州）股份有限公司
保荐代表人姓名：包红星	联系方式：010-56052591 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
保荐代表人姓名：郭泽原	联系方式：010-56052363 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕1012 号文”批准，联芸科技（杭州）股份有限公司（简称“公司”或“联芸科技”）首次公开发行股票并在科创板上市。本次公司发行新股的发行价为 11.25 元/股，募集资金总额为 112,500.00 万元，扣除发行费用 9,163.42 万元后，实际募集资金净额为 103,336.58 万元。本次公开发行股票于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与联芸科技签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解联芸科技经营情况，对联芸科技开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，	2025 年上半年，联芸科技在持续督导期间未发生按有关规定须保

	工作内容	持续督导情况
	应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2025 年上半年，联芸科技及相关当事人在持续督导期间未发生相关事项。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导联芸科技及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促联芸科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构督促联芸科技严格执行内部控制制度并规范运行。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促联芸科技严格执行信息披露管理制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补	2025 年上半年，保荐机构对联芸科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

	工作内容	持续督导情况
	充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2025 年上半年，联芸科技及其实际控制人、董事、高级管理人员未出现该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2025 年上半年，联芸科技及其实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2025 年上半年，经保荐机构核查，联芸科技不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2025 年上半年，联芸科技未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实	2025 年上半年，联芸科技不存在需要专项现场检查的情形。

	工作内容	持续督导情况
	际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2025 年上半年，联芸科技不存在未履行承诺的情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现联芸科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

集成电路设计行业具有竞争激烈、研发投入大、不确定性较高、产品更新换代较快的特点。根据发展战略，公司将结合技术发展和市场需求确定新产品的研发方向，基于多年固态硬盘主控芯片的技术积累，研发更高集成度、更优性能的 PCIe Gen5 主控芯片，并向嵌入式存储主控芯片领域延伸；同时，公司基于现有的 AIoT 信号处理及传输芯片的技术储备，将产品线向车规级芯片等领域不断延伸。

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例超过 40%。固态硬盘主控芯片涉及领域较多，且每款接口的升级迭代速度较快，目前正从 SATA 向 PCIe 3.0、PCIe 4.0、PCIe 5.0 切换，公司数据存储主控芯片业务如未来未能顺利推出支持新技术、新标准的芯片产品或未能成功切入嵌入式存储领域，将对公司经营业绩产生不利影响。AIoT 信号处理及传输业务尚处于起步阶段，但是研发投入较大，尤其是有线通信芯片，尚未形成大规模销售。由于 AIoT 芯片设计的技术要求高、工艺复杂，且流片成本较高，若公司产品研发失败，存在前期投入资金无法收回的风险。同时，AIoT 领域技术迭代迅速，新的信号处理算法、传输协议不断涌现。公司若不能及时跟上技术更新步伐，研发出适配新技术标准的芯片产品，其现有的产品可能因技术落后而失去竞争力。

（二）经营风险

1、经营业绩波动风险

报告期内，公司经营业绩的波动主要受营业收入变化和研发费用持续增加等因素影响。若未来公司产品所属下游行业需求下滑，或公司未能持续加大技术研发、拓展客户需求，将会产生公司产品售价下降、销售量减少等不利情形，进而导致公司经营业绩下滑。

2、客户集中度较高风险

在业务发展初期，公司专注于研发且优先与各领域的头部客户合作，对其他客户的开拓需要分时间、分阶段完成，公司的芯片产品主要采用直销模式向模组厂商或终端设备厂商销售产品，受已开发完成的客户持续放量、新客户尚处于开拓周期、产品下游应用领域等因素影响，公司存在客户集中度较高的情况。公司的经营业绩与下游模组厂商、终端设备厂商的经营情况相关性较高，如未来该等厂商的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与该等厂商的合作关系发生变化，公司将面临订单减少或流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

3、供应商集中风险

公司为典型的采用 Fabless 经营模式的集成电路设计企业，专注于芯片设计，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等生产环节采用委托第三方企业代工的方式完成。由于集成电路行业的特殊性，晶圆生产制造环节对技术及资金规模要求较高且市场集中度很高，能够满足公司业务需求的具备先进工艺的厂商数量更少。行业内，众多集成电路设计企业出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别晶圆厂和封测厂进行合作。

由于主要供应商集中，如果供应商发展经营不善或与公司合作受限，公司需要短期内找到合适的替代供应商，否则将影响产品的稳定生产。同时，如果未来国际出口管制和贸易摩擦加剧，使得公司相关原材料进口受到限制，影响订单正常履行，也将会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

公司备货增加，期末存货账面价值 45,388.10 万元，占期末资产总额的比例 20.81%。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

2、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 30,136.30 万元，占期末资产总额的比例为 13.82%，应收账款账面余额占当期营业收入的比例为 50.10%。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能继续增加，若下游客户财务状况出现变化丧失还款能力，可能导致应收账款无法全部回收，进而对公司未来业绩、现金流量造成不利影响。

（四）行业风险

数据存储主控芯片行业集中相对高，主要企业包括三星、西部数据、慧荣科技、联芸科技等，但也不缺新兴进入者的搅局。公司虽然在 SSD 主控芯片领域占有全球重要一席，市场份额逐年提升，但依然要面对技术的迭代创新速度、后进入者的杀价及阶段性支持资源不足丢失市场的风险。另外，嵌入式存储主控芯片是公司最新进入的业务领域，该领域主要被海外厂商垄断，市场拓展遇到的挑战更大。

AIoT 信号处理及传输芯片具有较高的技术、应用和资金壁垒，全球拥有突出研发实力和规模化运营能力的芯片厂商主要集中在境外，美满电子和瑞昱等国际巨头呈现高度集中的市场竞争格局。与上述行业龙头相比，公司在市场份额、产品布局、经营规模、盈利能力等方面均存在明显差距。公司目前在 AIoT 信号处理及传输芯片领域仍属于起步阶段，如果未来市场推广不如预期，可能存在无法实现进一步大规模销售的情况。

（五）宏观环境风险

近年来，国际贸易中部分国家针对半导体设备领域颁布了一系列对中国的出

口管制政策，同时，陆续将多家中国半导体企业纳入“实体清单”（Entity List）和“未经核实清单”（Unverified List），限制其采购受《出口管制条例》管辖的物品。

随着全球主要经济体经济增速持续放缓，贸易保护主义及国际经贸摩擦的风险仍将存在，不能排除国际贸易政策未来变化会对国内芯片设计企业带来一定的限制和不利影响，从而影响本土半导体产业链完整、持续、稳定的发展。如果贸易政策发生不利变化，公司可能面临相关订单减少的局面，进而对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，联芸科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年 1-6 月，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减（%）
营业收入	609,721,474.32	527,082,216.87	15.68
归属于上市公司股东的净利润	56,134,963.73	41,161,903.17	36.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,093,418.32	17,619,147.11	99.18
经营活动产生的现金流量净额	-17,969,442.78	-137,933,181.05	不适用
主要会计数据	2025 年 6 月末	2024 年 12 月末	本期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,792,604,803.32	1,709,848,206.17	4.84
总资产	2,180,923,590.44	2,086,479,098.25	4.53

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00

主要财务指标	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
加权平均净资产收益率 (%)	3.21	7.52	减少 4.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.00	3.22	减少 1.22 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	40.89	37.68	增加 3.21 个百分点

2025 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、本报告期营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系：

1) 受益于下游需求的温和复苏以及 AI 技术不断发展使得终端应用对于数据存储方面的需求不断增长，公司数据存储主控芯片的整体出货量保持增长；

2) 公司的产品竞争力、品牌影响力不断提升，在下游客户中的渗透率持续提高；

3) 毛利水平更高的 PCIe Gen4 SSD 主控芯片的收入占比持续增加，进而带动了公司毛利率的提升。

2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所改善，主要系本报告期销售回款较去年同期大幅增加。

3、本报告期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加，主要系本报告期净利润同比增加。

4、本报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降，主要系公司于 2024 年 11 月发行股票上市使净资产规模大幅增加。

六、核心竞争力的变化情况

2025 年 1-6 月，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）自主创新的研发平台体系

联芸科技自创立以来，持续专注于技术研发和创新，建立了以研发平台为核心的多部门协调参与的研发体系，构建起围绕 SoC 芯片设计平台的技术研发、

中后端设计服务、芯片验证等多环节研发体系。公司基于多年对电路设计、工艺制造、封装测试等环节从业经历与经验，针对不同产品线技术及市场发展特点，构建可共享、可复用的 IP 及 SoC 架构设计技术，最大限度地降低研发成本，实现了研发资源的高效共享，缩短产品从设计到量产的研发周期。公司根据不同产品线技术特点，通过大量数据分析及模拟验证，总结出不同产品线产品设计的技术要点，建立针对不同产品线可共享复用的设计 IP 模块，为后续跨产品线芯片产品快速量产和演进打下坚实基础。

在数据存储领域，公司积累了丰富的经验和技術，尤其在功耗、性能、颗粒适配性和可靠性等方面取得了多项突破，紧跟存储技术的变化推出具有市场竞争力的产品，目前已成功量产了 10 余款产品，在 SSD 主控领域形成完整布局的同时进一步拓展至嵌入式存储领域，是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。在 AIoT 领域，公司在存储主控芯片开发过程建立的技术平台基础上，不断优化创新，并在感知接口、DSP 设计、以太网 PHY 收发器模拟架构等方面形成核心技术，根据客户的需求推出了一系列具有较强竞争力的芯片产品。

同时，公司的核心技术基于自主知识产权，形成了有规划、有策略的专利布局，截至 2025 年 6 月末，公司已获授权的国内外发明专利达 86 项。

（二）已进入众多行业头部客户的供应链体系

公司经过多年的积累和发展，在业内获得了广泛认可，已成为了具有一定影响力的芯片设计公司，同时，公司也十分重视头部客户，长期以来能够快速响应其多样化的需求，这也为公司形成了坚实的客户基础。在数据存储主控领域，公司的 SSD 主控芯片可搭载全球七大 NAND 原厂颗粒，并且已广泛应用于全球大部分主流存储模组厂的 SSD 产品，在消费级零售渠道领域的市场份额处于领先地位。在消费级 PC-OEM 前装 SSD 应用领域，公司的主控芯片也已广泛应用于众多品牌 PC 电脑中，与 PC 品牌厂已建立了稳定的合作关系。同时，未来随着存储模组厂在 PC-OEM 前装市场渗透率的不断提升，公司也有望进一步扩大市场份额。

在嵌入式存储领域，公司的潜在下游客户与 SSD 领域高度一致，而这些合作伙伴也在通过提升自身的产品竞争力取得更多的市场份额，因此与其长期的稳

定合作关系将是嵌入式存储主控芯片未来能够快速取得市场份额的重要资源。

在 AIoT 感知信号处理与传输芯片领域，公司相关产品也获得 AIoT 头部企业的规模商用，与头部客户建立了深度且长期的合作关系，该等客户的认证也有利于公司市场影响力的提升，未来随着自身产品竞争力的提升、产品组合的多元化，公司的 AIoT 芯片有望在更多的应用领域实现突破。

（三）经验丰富的人才团队

公司拥有一支高素质的设计研发人才队伍，截至 2025 年 6 月 30 日，联芸科技研发团队规模达到 583 人，公司研发人员占总员工比例达到 81.08%。公司研发人员理论基础扎实、实践经验丰富、知识结构合理，具备并行开发多款数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片能力，在公司各个关键岗位上发挥重要作用，能够有力支撑公司的技术创新和产品迭代，保证研发任务的顺利完成。

（四）相辅相成的业务布局

公司产品线从最初的数据存储主控芯片到 2017 年布局 AIoT 感知信号处理芯片，并在 2019 年开始布局有线通信芯片业务。经过十年多的发展，初步构建起从感知信号处理、数据有线传输到数据存储所需的核心芯片，形成多样化产品布局 and 多元化业务矩阵，抗风险能力持续增强。

集成电路芯片的研发具有出错成本高、资金投入大、开发周期长等特点，同时 AIoT 市场仍处于快速发展周期，新技术、新产品层出不穷，带来了芯片产品能够快速实现技术更新迭代的要求，比如智能家居、汽车电子等行业。而公司数据存储主控芯片和 AIoT 感知信号处理及传输芯片同属于系统级大规模集成电路芯片（SoC），在技术上可以充分实现通用 IP 技术共享、SoC 芯片设计平台技术共享，不仅有效节省了芯片研发成本，缩短了芯片研发周期，而且降低了芯片出错概率。另外，公司数据存储主控芯片和 AIoT 感知信号处理及传输芯片全面应用于数据的处理、传输、存储，相辅相成，终端客户群也高度一致，能够最大发挥多样化产品矩阵优势，更好地满足客户在 AI 浪潮下对于数据处理、传输和存储方面不断增长的需求。

上述公司的核心竞争力在 2025 年 1-6 月未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

2025 年上半年，公司持续保持高力度的研发投入，研发费用为 24,930.80 万元，较上年同期增长 25.53%。截至 2025 年 6 月末，公司研发人员人数为 583 人，同比增长 11.26%。

公司建立了完善的知识产权管理体系，实现对知识产权的保护。2025 年上半年公司共申请发明专利 25 件，获得授权发明专利 7 件。截至 2025 年 6 月底，公司累计拥有有效授权发明专利 86 件、软件著作权 62 件、集成电路布图设计 27 件。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	1,125,000,000.00
减：已支付的发行费用	91,633,240.23
募集资金累计使用金额（包括实际已置换先期投入金额）	257,169,087.56
加：募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额	3,518,559.63
截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	779,716,231.84
减：暂时闲置募集资金现金管理	400,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	379,716,231.84

公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及

减持情况

本持续督导期间，公司实际控制人、董事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 包红星
包红星

郭泽原
郭泽原

